

迈芯维miniCOB的封装工艺

产品名称	迈芯维miniCOB的封装工艺
公司名称	深圳市康普信息技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦A1104、A1104-1、A1104-2、A1104-3
联系电话	0755-21038002 18565839923

产品详情

1, 扩晶：选用扩大机将生产商提供的一整张LED芯片塑料薄膜匀称扩大，使黏在塑料薄膜表层紧密排列的LED结晶体打开，有利于刺晶。

2, 不干胶贴纸：将扩好晶的扩晶环放入已刮好导电银浆层的背胶机表面，身上导电银浆。点导电银浆。可以用散称LED芯片。选用自动点胶机将适度导电银浆点在PCB板上。

3, 将配全导电银浆的扩晶环放进刺晶架中，由操作工在光学显微镜将LED芯片用刺晶笔刺在PCB印刷电路板上。

4, 将刺好晶的PCB印刷电路板放进热循环烘箱中温控静放一段时间，待导电银浆固化后取下（不能久置

[LED芯片关联](#)，那么就需要以上几个流程；仅仅只是IC芯片邦基本规律注销之上流程。

5, 粘处理解决处理芯片：用自动点胶机在PCB印刷电路板的IC位上适度红胶(或uv胶)，换掉防静电设备(真空吸笔或子)将IC裸片适度放入红胶或uv胶上。

6, 烘干处理：将粘牢裸片放进热循环烘箱中放入大平面图发热板上温控静放一段时间。

7, 关联(打线)：选用铝丝焊线机将解决处理芯片(LED结晶体或IC芯片)与PCB板里相匹配焊层铝丝开展桥接模式，即COB的构造电力线电焊焊接。

8, 前测：应用专用型测试工具检验COB板，将不符合要求的实木板再一次维修。

9, 涂胶：选用自动点胶机将配备好一点的AB胶适当具体地址到邦预订LED结晶体上，IC则以uv胶封装形式，然后根据企业标准进行外型封装形式。

10, 凝结：将堵死胶PCB印刷电路板放进热循环烘箱中温控静放，根据自己的喜好能设不同种类烘干时间。

11, 后测：将封装形式好一点的PCB印刷电路板换掉专用测试工具开展电性能检测，区别优劣好坏。

与其他封装工艺对比，COB专业能力****（仅仅只是同解决处理芯片1/3上下）、节约空间、性能稳定。